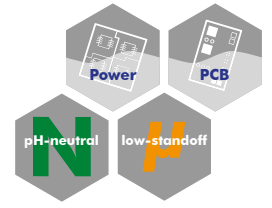


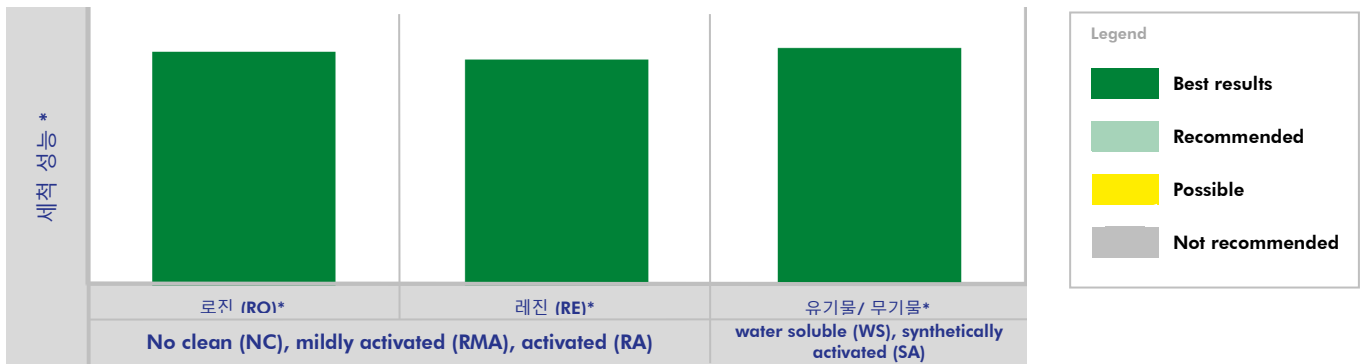
## VIGON® PE 180



전력 반도체와 PCBA 세척을 위한 pH 중성의 세척 용액

VIGON® PE 180은 스프레이 분사 방식 장비에서 전력 반도체와 PCBA 세척을 위해 개발된 수계기반 중성 세척제입니다. VIGON® PE 180은 플럭스 잔사를 안정적으로 제거하며, 물질 호환성이 높아 PCBA 뿐만 아니라 리드프레임, 개별 부품, 파워 모듈, 파워 LED 세척에도 사용됩니다. 또한 와이어 본딩, 몰딩 및 접착제 본딩과 같은 후속 공정을 위해 구리 표면의 산화막을 잘 제거하는 것이 특징입니다.

### 적용 범위 - 전력 반도체 및 PCBA 디플럭싱(Defluxing)



\* J-STD-004

### 다른 세척제와 비교 시 이점

- 전력 반도체와 PCBA 세척에서 우수한 성능을 가집니다.
- 와이어 본딩, 몰딩 및 접착제 본딩과 같은 후공정을 위해 구리 표면의 산화막을 제거합니다.
- pH 중성 용액으로, 물질 호환성이 좋습니다.
- MPC® 구조로 이루어져 쉽게 린스가 가능합니다.
- 인화점이 없어 방폭 장치가 필요하지 않고, 거품이 생기지 않아 모든 스프레이 분사 방식 장비에 적합합니다.

### 공정 단계

세척 공정	부품	1. 세척	2. 린스	3. 건조
Spray-in-air (스프레이 분사) (inline & batch)	전력 반도체, PCBA	VIGON® PE 180	DI-water <sup>1</sup>	Hot air
딤 탱크 (US / SUI)	전력 반도체, PCBA	VIGON® PE 180	DI-water <sup>1</sup>	Hot air

<sup>1</sup> DI-water 의 온도는 20-40°C/68-104°F 를 권장합니다.